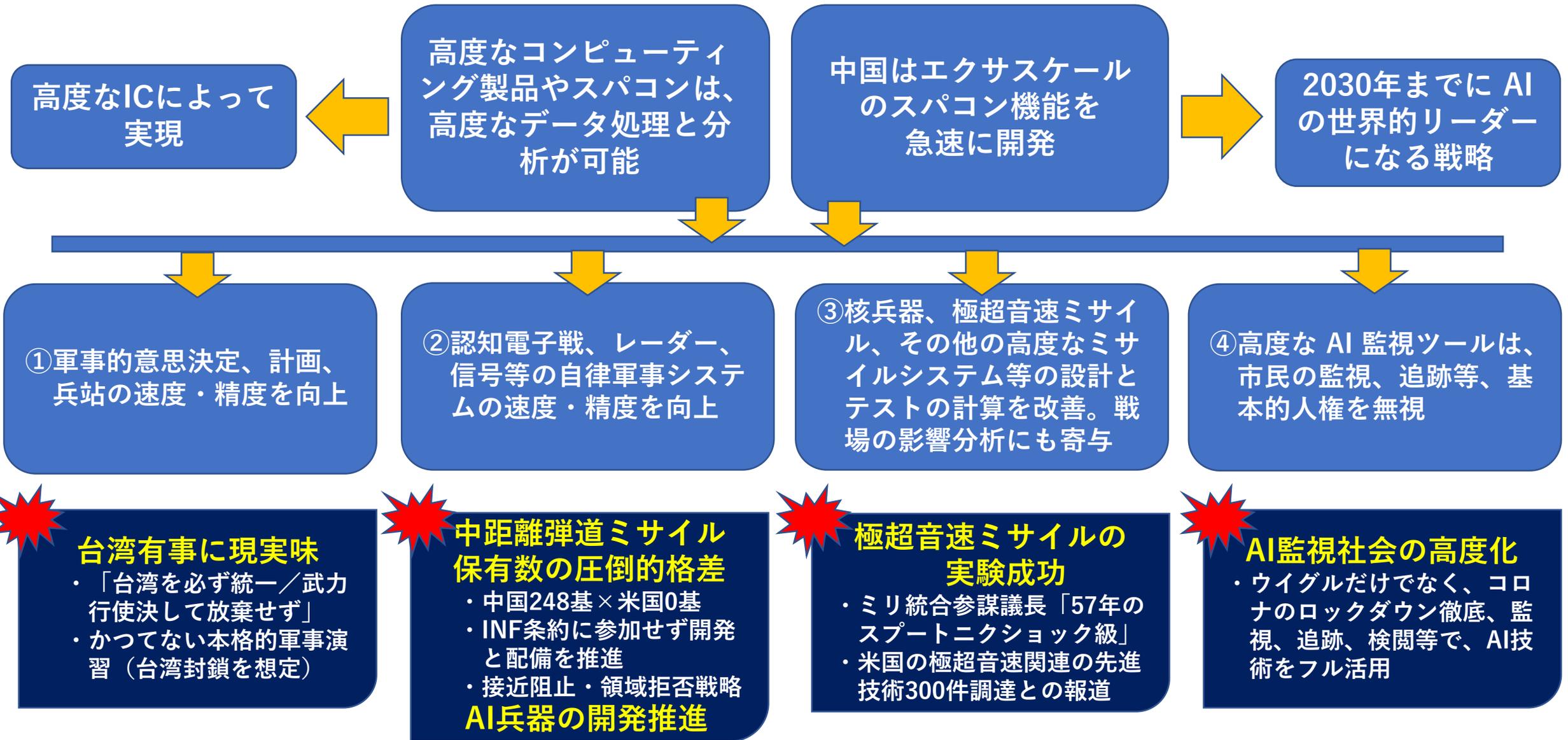


**米国による対中輸出規制の
著しい強化の全体概要図
(22.10.7公布)**

**2022.11.21
CISTEC事務局**

米国商務省BISによる背景説明概要 (部分)



1.メインとなる規制—エンドユース規制+リスト規制

輸出・再輸出・同一国内移転の禁止

半導体製造関連エンドユース規制

【半導体製造に必要な品目の禁輸】

<中国での「半導体製造施設」向けの禁輸>

①先端半導体(3類型※)を製造していることを知り/知り得る場合

※回線幅16nm又は14nm以下のロジック半導体/ハーフピッチが18nm以下のDRAM/積層数が128層以上のNAND型フラッシュメモリー
⇒開発・製造用途のEAR対象品目すべて

②先端半導体を製造しているかどうかわからない場合

⇒一定のECCN該当の検査・試験・製造装置、材料、技術

<中国向けの半導体製造装置等開発・製造用途の禁輸>

※「半導体製造施設」向けの限定なし

※先端半導体を製造していないことが分かっている場合も対象

⇒ECCN新設の半導体成膜装置とそのためのソフトウェア、技術用途も禁輸

半導体・半導体製造関連のリスト規制

【半導体そのもの/半導体製造に必要な品目の禁輸】

<半導体そのものの禁輸>

①一定の先端コンピューティング等IC/一定のスパコン等用IC

ASIC、FPLD、GPU、TPU、各種プロセッサ（ニューラル、インメモリー、ビジョン、テキスト、アダプティブ）、コプロセッサ、アクセラレータ

<半導体製造のための装置、ソフトウェア、技術の禁輸>

②半導体成膜装置/その開発・製造のために設計されたソフトウェア/それらの装置・ソフトウェアの開発・製造のための技術

③一定の先端コンピューティング等用ICの開発・製造のために設計されたソフトウェア/そのソフトウェア開発・製造のための技術

スパコン関連エンドユース規制

【スパコンの開発・製造等に必要な品目の禁輸】

<中国所在/中国向けの禁輸>

①スパコンの開発・製造・使用・操作・据付・保守・修理等に使用されることを知り/知り得る場合

②スパコンで使用される部分品・機器への組み込み/それら部分品・機器の開発・製造に使用されることを知り/知り得る場合

⇒一定のECCN該当のIC

⇒一定のECCN該当のコンピュータ、電子組立品、部分品

関連規制1：最先端半導体の開発・製造に関する規制

①全周ゲート電界効果トランジスタ（GAAFET）搭載のIC開発に必要な電子コンピューター支援設計（ECAD）ソフトウェア

②ウルトラワイドバンドギャップ半導体材料（ダイヤモンド、酸化ガリウム等）

関連規制2：EL掲載のSMIC向けの許可対象を厳格化

○禁輸対象を、線幅10nm以下の半導体製造可能な品目から、14nm以下に拡大。

関連規制3：CHIPS・科学法のガードレール条項

○米国工場建設等の補助金を得た企業は、中国等の懸念国で線幅28nm以下の半導体生産を著しく拡大することを10年間禁止

純粹民間用途でも許可例外なしで原則禁輸！

西側企業の中国現地工場向けはケースバイケースで判断（技術レベル、エンドユーザー、コンプライアンスレベル等を考慮）。

①AI、データセンター、スパコンに多大な影響。
②半導体成膜装置は半導体製造の中核で、新興・基盤的技術の實質的性格。

先端コンピューティング用半導体と関連ソフト・技術、それを組み込んだコンピュータの製造用途の、非懸念国企業の中国現地工場向けは一時的一般許可。非懸念国へ輸出のみ可（23.4.7まで）。

3つの直接製品規制

【米国外で米国原産技術・ソフト・機器から直接製造した品目の再輸出・同一国内移転の禁止】

<中国所在／中国向けの禁輸>

【①～③各記載のことを知り/知り得る場合】

①28のEntityList掲載企業向けの直接製品規制

- 米国製の一定のECCN該当の機器・技術・ソフトウェア（エレクトロニクス、コンピュータ、通信等の技術・ソフト）を使って製造した製品等が、掲載者が製造・購入・注文した製品・部品等に組み込まれるか/その製造・開発に利用されること。
- それらの品目の再輸出・同一国内移転に、掲載者のいずれかが関与していること。

②先端コンピューティング直接製品規制

- 米国製の一定のECCN該当の機器、技術・ソフトウェアを使って製造した製品・技術を使って製造した製品・技術(先端コンピューティング用等の一定の半導体やそれを組み込んだコンピュータやその技術等に限られる)であって、
 - ・上記製品・技術が、中国向けの製品・部品等に組み込まれること。
 - ・上記技術が中国企業等又はそれらの中国内外の子会社等によって開発された技術であって、マスク、半導体のウェハー又は半導体のダイのためのものであること。
- ※この場合、中国向けに限らず、全世界への再輸出・国内移転が許可要。

③スパコン用途直接製品規制

- 米国製の一定のECCN該当の機器、技術・ソフトウェアを使って製造した製品・技術を使って製造した製品・技術であって、上記製品・技術が、中国所在／中国向けの
 - ・スパコンの開発・製造・使用等に利用されること。
 - ・スパコンの機器、部品等に組み込まれること/その開発・製造に利用されること。

2.強力な補完的規制—米国外、EAR対象外への規制

U.S.Personの半導体開発・製造の関与規制

【半導体製造エンドユース規制の補完として、EAR対象外品目に関与禁止】

<以下の品目の中国への/中国内の出荷・移送・移転/それらの支援・サービス提供の禁止>

- 半導体製造施設が先端半導体を製造していることを知り/知り得る場合の、その開発・製造に使われる EAR 対象外品目
- 半導体製造施設が先端半導体を製造しているか分からない場合の、EAR 対象外で CCL の半導体等のエレクトロニクス分野の試験装置・検査装置・製造装置、材料、ソフトウェア、技術
- 新設のECCNパラメータ該当の半導体成膜装置とそのためソフトウェア、技術

関連規制4：長江メモリーを未検証ユーザーリスト(UVL)に掲載

- エンドユース等の輸出許可前チェック (PLC) や出荷後検証 (PSV) により、その正当性・信頼性を検証できない場合に掲載

関連規制5：EntityList掲載要件の拡大・強化

- 従来の「米国の国家安全保障又は外交政策に反する者」に加え、「米国の国家安全保障又は外交政策に反する重大なリスクがある者」を追加規定
- 追加規定に基づき掲載事例として、UVL 掲載者への米国政府によるチェックが、その UVL 掲載者の所在国政府の協力欠如により十分に実施できない場合を規定
- UVL掲載されていない企業の場合でも、「重大なリスク」があるとの説明

ファウウェイ向け以上に広汎に、日韓台蘭等からの輸出を規制

米国籍の者（特に中国系）に大きく依存している中国企業に多大な影響・打撃

半導体・半導体製造関連のリスト規制の補完として非米国からの輸出を規制

米国の機器・技術を使って出来た中国企業の技術が、世界の市場を侵食することを防止

今回の中国向け新規制の実効性を担保する強力な手段に。チェック拒否すればEL掲載に。